# 表面実装ローパスフィルタ・DC–1100 MHz

基板設計前に 50 Ω の接続、表面実装用ランド形状、パッケージ寸法 18.8 × 11.18 × 6.86 mm を確認してください。

## RF 特性

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 通過帯域 | DC–1100 MHz |
| 通過帯域内挿入損失 [1] | 0.9 dB (代表値) |
| 阻止域減衰量 [2] | ≥20 dB |
| VSWR [1] | 1.3:1 (代表値) |
| –3 dB 周波数 | 1225 MHz |

[1] DC–1100 MHz
[2] 1440–8500 MHz

## 設計定格 設計保証

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 許容電力 | 1 W |
| 動作温度 | –40…+85 °C |
| 保存温度 | –55…+100 °C |

## 代表実測応答

| 周波数 (MHz) | S11 VSWR | S12 損失（dB） | S12 遅延（ns） |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | -0.01 | 1.16 |
| 103 | 1.05 | -0.06 | 0.87 |
| 206 | 1.12 | -0.11 | 0.88 |
| 309 | 1.19 | -0.17 | 0.89 |
| 411 | 1.24 | -0.22 | 0.91 |
| 514 | 1.26 | -0.27 | 0.95 |
| 617 | 1.2 | -0.3 | 1 |
| 720 | 1.06 | -0.32 | 1.07 |
| 823 | 1.18 | -0.42 | 1.15 |
| 926 | 1.51 | -0.63 | 1.25 |
| 1029 | 1.71 | -0.89 | 1.48 |
| 1131 | 1.21 | -0.94 | 2.01 |

## 代表実測応答

| 周波数 (MHz) | S11 VSWR | S12 損失（dB） | S12 遅延（ns） |
|---|---|---|---|
| 1234 | 4.38 | -4.24 | 2.09 |
| 1337 | 20.14 | -13.76 | 1.46 |
| 1440 | 38.12 | -22.68 | 1.04 |

## 機械仕様

| 項目 | 値 |
|---|---|
| パッケージ寸法 | 18.8 ±0.2 × 11.18 ±0.2 × 6.86 ±0.2 mm |
| RF インピーダンス | 50 Ω |
| 実装方式 | 表面実装 |
| RF 端子 | 1, 8 |
| グラウンド端子 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 品質グレード | 産業用 |
| はんだパッド寸法 | 1.52 × 1.4 mm |
| 同列の隣接パッド中心間ピッチ | 5.08 mm |
| パッド配列の外縁間寸法 | 16.76 × 11.94 mm |

## 基板実装

清掃時は製品の表面を拭き、洗浄液に浸さないでください。 220 °C のリフローはんだ付けに対応します。 PCBランドパターンは4パッドずつの2列です。端子1が左上となる底面視で、上段は1、3、5、7、下段は2、4、6、8です。端子1と8はRF入出力用です。端子2～7はグラウンドに接続します。 底面視で端子1の切り欠き幅は1.52 mm、上端からの奥行きは1.02 mmです。端子2と4の中心間隔は5.08 mmで、端子2の中心は左端から1.78 mmです。端子8のメタライズ部は右端から3.54 mm、下端から2.22 mmの範囲です。

**文書に関する注意**

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。